

國立交通大學

材料科學與工程所

碩士論文

以凱文結構與三微模擬研究電遷移造成覆晶鉚錫接  
點中孔洞的形成

Study of void formation due to electromigration in  
flip-chip solder joints using Kelvin bump probes and 3D  
Simulation

研究生：張元蔚

指導教授：陳智 教授

中華民國九十六年一月